



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社 S U M C O  
代表者名 取締役社長 橋本 眞幸  
(コード: 3 4 3 6 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR室長 澁谷 博史  
(TEL. 03-5444-3915)

### 業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、本年 2 月 14 日に開示した平成 26 年 12 月期 第 2 四半期連結累計期間（平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日）の業績予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 連結業績予想数値の修正

平成 26 年 12 月期 第 2 四半期連結累計期間（平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	102,000	9,000	6,500	4,500	15.28
今回修正予想 (B)	107,000	12,000	10,000	7,500	26.92
増減額 (B-A)	5,000	3,000	3,500	3,000	
増減率 (%)	4.9%	33.3%	53.8%	66.7%	
(ご参考)前年同期実績 (平成 25 年 12 月期 第 2 四半期連結累計期間)	100,635	11,853	3,740	123	△1.68

(注) 当社は、平成 25 年 12 月期より決算日を 1 月 31 日から 12 月 31 日に変更しました。これに伴い、当第 2 四半期連結累計期間（平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日）と前第 2 四半期連結累計期間（平成 25 年 2 月 1 日～平成 25 年 7 月 31 日）は、期間が異なります。

#### 2. 修正の理由

当第 2 四半期連結累計期間における半導体用シリコンウェーハ市場は、スマートフォンやタブレットを主体とした携帯情報端末需要が強いことから、ロジック・メモリー向け 300mm ウェーハ販売は想定を上回る見込みとなりました。また、小口径ウェーハについても、車載向けを始めとした民生・産業用パワー半導体や各種アナログ・ロジック等の需要増により、売上高が前回発表予想値を上回る見込みとなりました。

この結果、営業利益、経常利益及び四半期純利益についても、予想値を上回る見込みとなったことから、業績予想を修正することとしました。

(注) 当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、通期の業績予想について、現時点では合理的な予想を行うことが困難であることから、未定としております。なお、通期業績予想は合理的な予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。

(注) 業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上